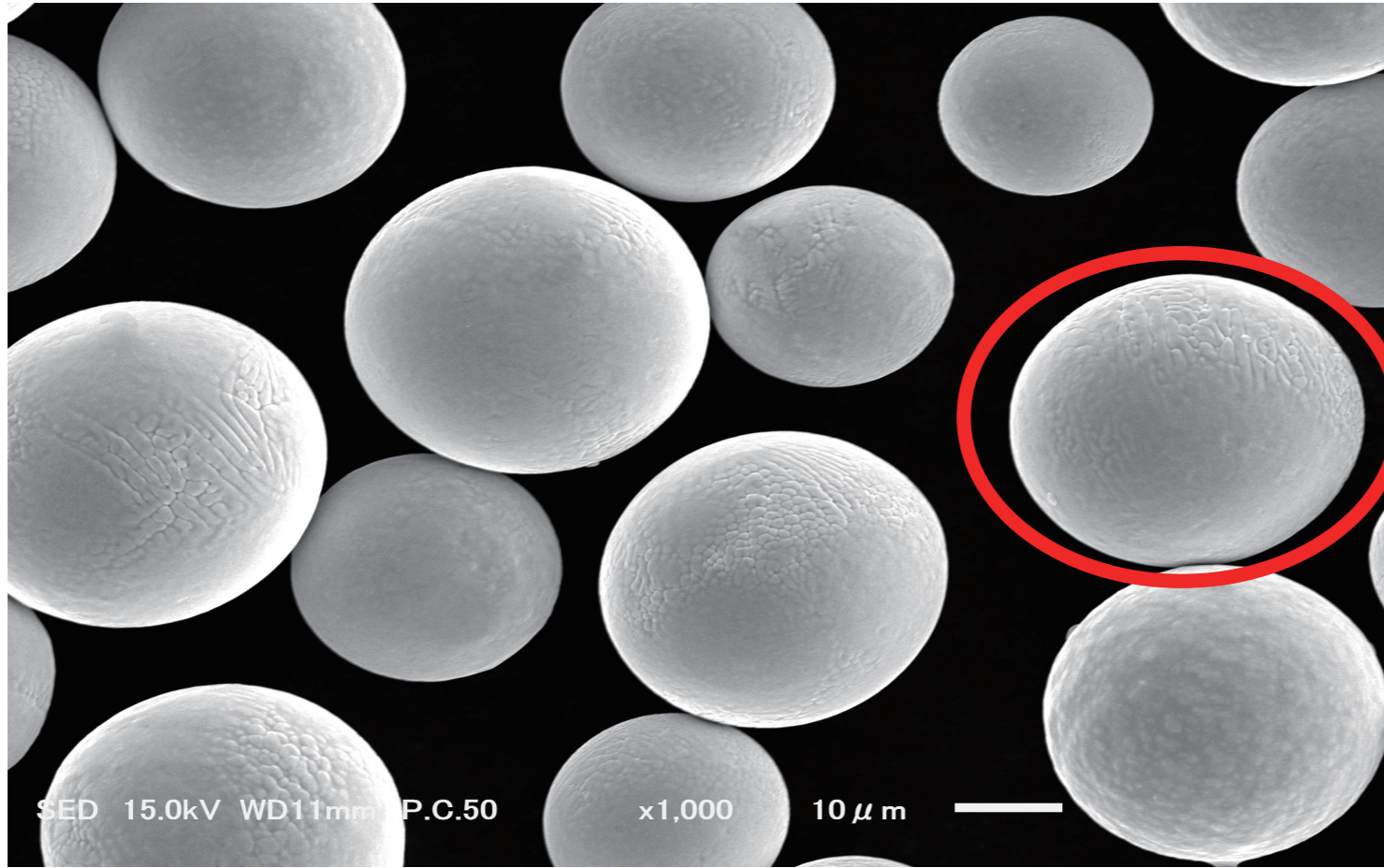


接合部の超微細化へ!

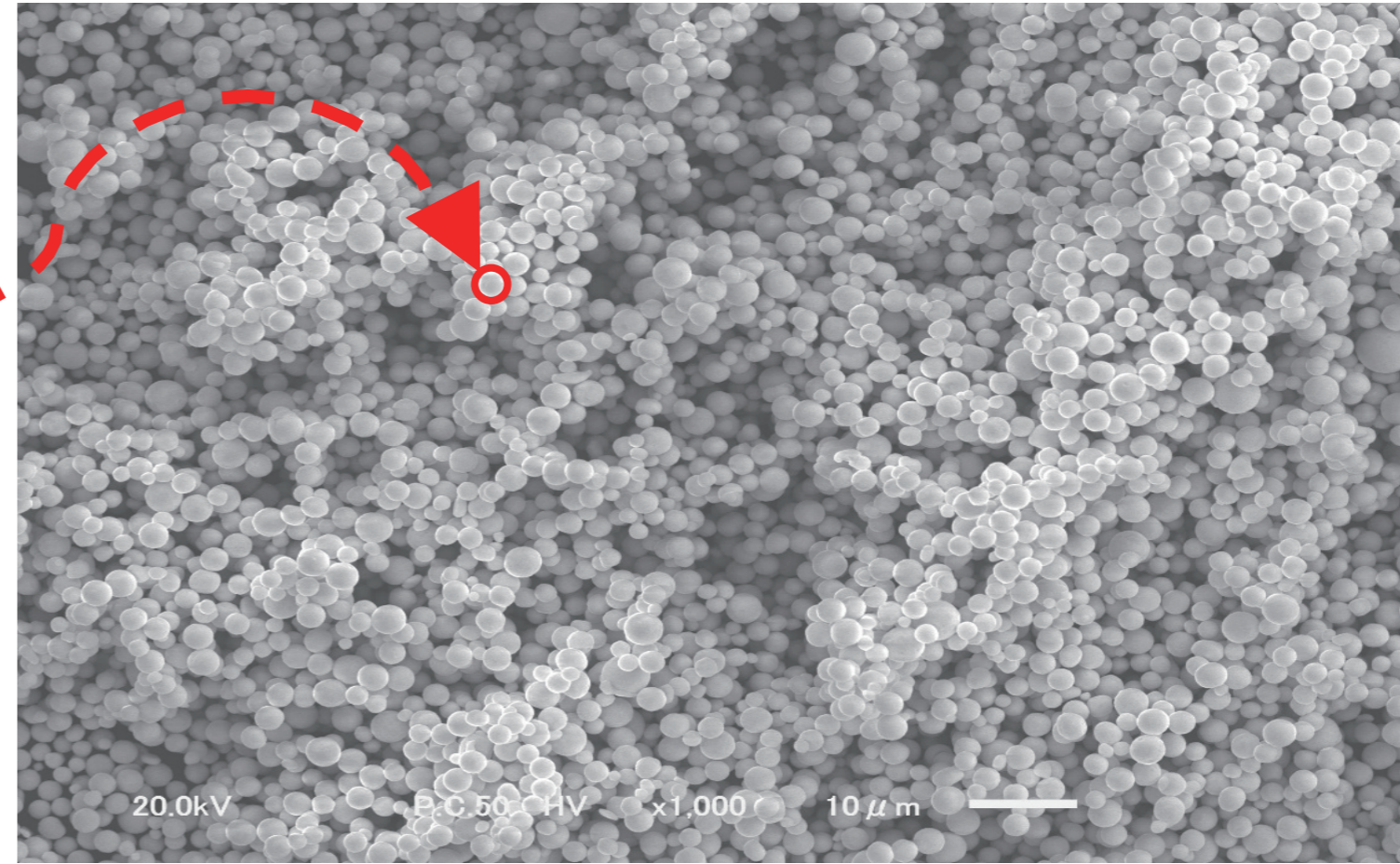
Toward Ultra-miniaturization of Joint!

超微細はんだ粉末Type9(1~5 μ m)適用製品

Products applied by Ultra-fine solder powder Type9 (1~5 μ m)



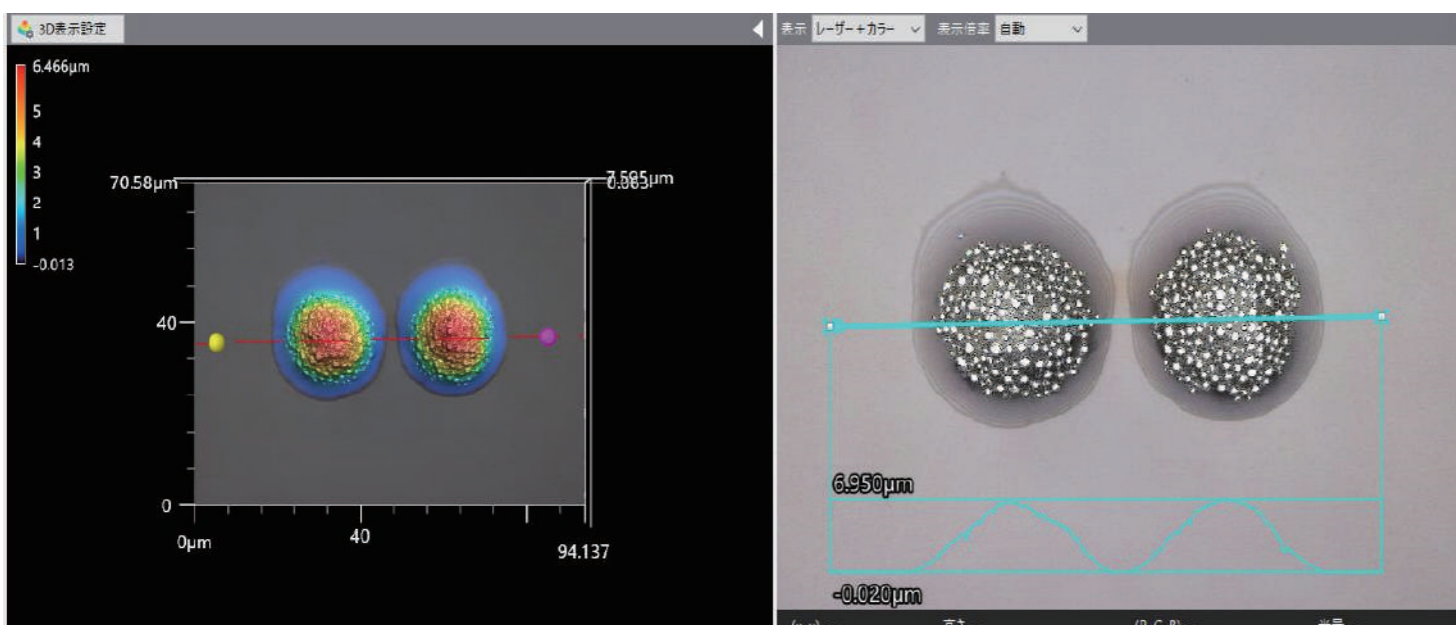
Type4:22-38 μ m



Type9:1-5 μ m

NP303-UFP501-T9 (印刷用) (for printing)

極薄マスク、極小開口でのマスク印刷に適応
Suitable for mask printing with ultra-thin masks and ultra-small apertures



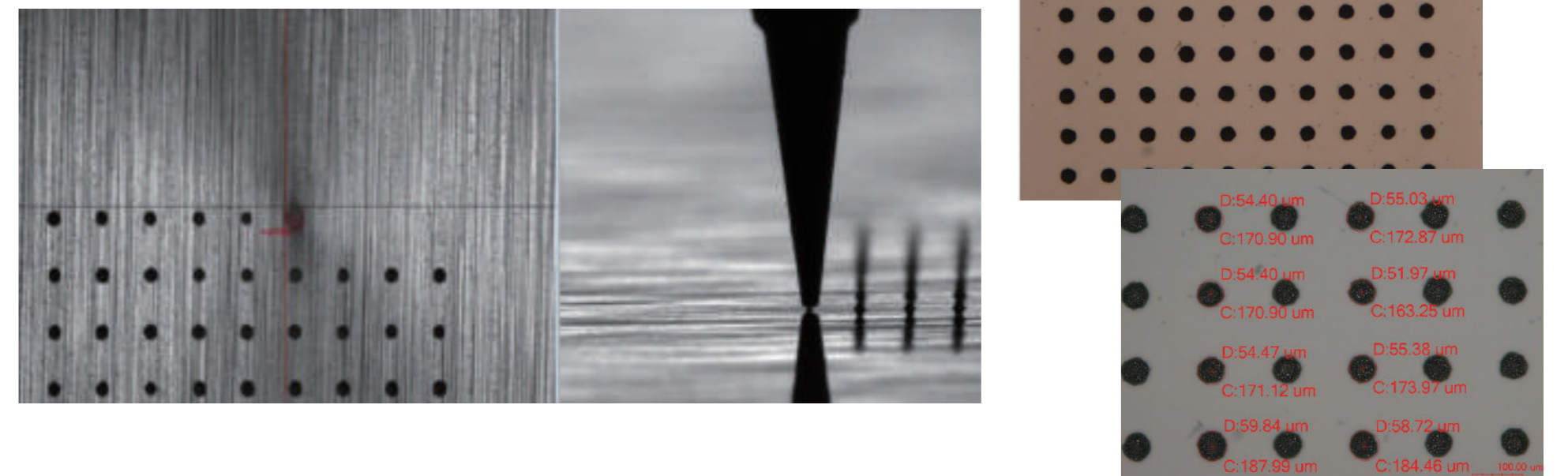
開口(Aperture):15 μ m
マスク厚(Thickness of Stencil):6 μ m

NP303-DPF201-T9 (ディスペンス用) (for dispense)

Twin-air方式により、
 Φ 50 μ mサイズのディスペンス供給が可能
Enable to dispense Φ 50 μ m size by Twin-air system

塗布試験結果 Test results of dispensing

Φ 50 μ m塗布可能
 Φ 50 μ m dispensing is possible

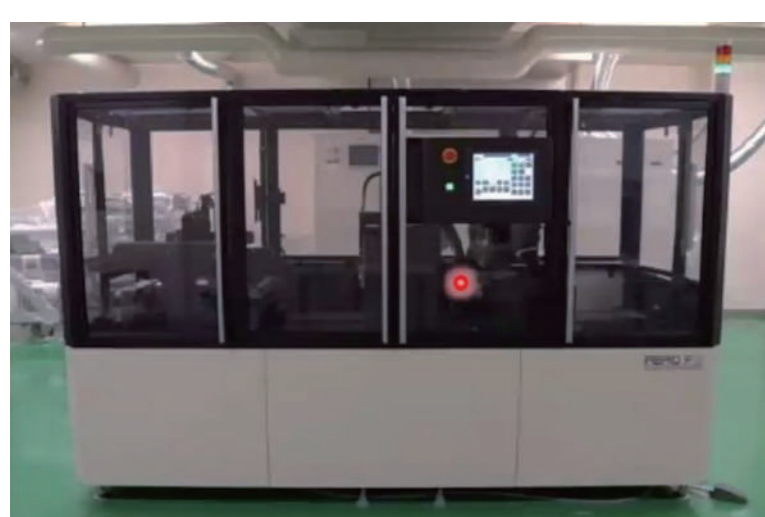
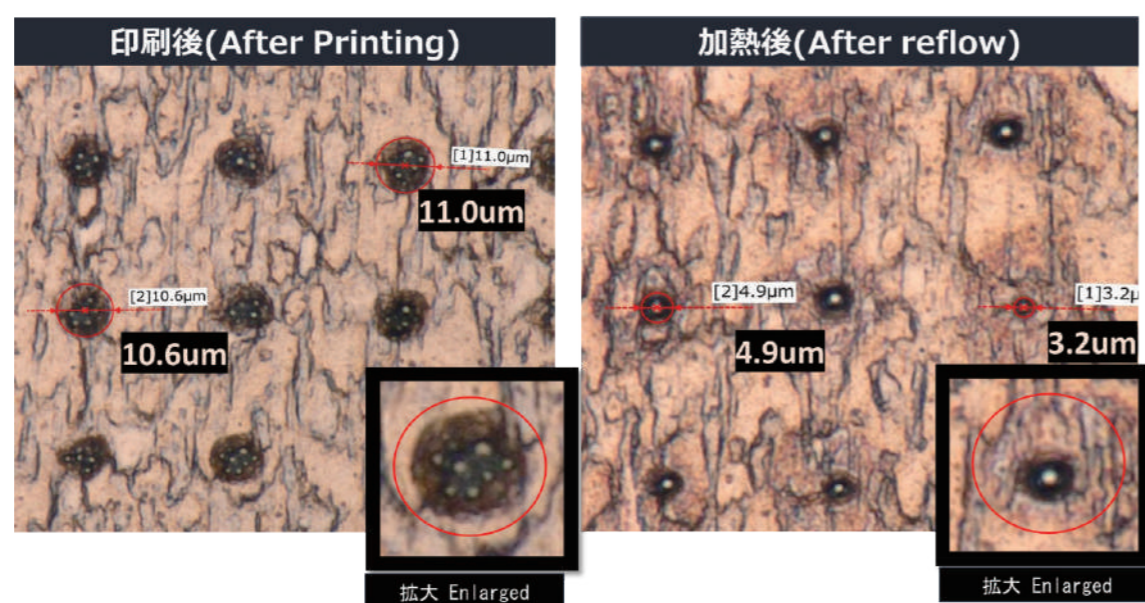


NP303-GOP501-T9 (グラビアオフセット印刷用) (for gravure offset printing)

グラビアオフセット印刷により、
 Φ 10 μ mサイズのはんだ印刷が可能
By gravure offset printing, solder printing of Φ 10 μ m size is possible



銅基板上印刷、リフロー
(Printing, Reflow on Copper substrate)
Diameter/Pitch
 Φ 10 μ m / 30 μ m



株式会社セリアコーポレーション様の
グラビアオフセット印刷機により
 Φ 10 μ m印刷を実現可能に
Gravure offset printer of Seria Corporation enable ϕ 10 μ m printing.

株式会社エンジニアリングラボ様のTwin-airディスペンサ搭載
ESシリーズにより、 Φ 50 μ m塗布を実現可能に!
ES series with Twin-air dispenser from Engineering Lab Inc. enables ϕ 50 μ m dispensing!



Φ 50 μ m以下も可能
Possible under Φ 50 μ m

ES10, 12 ES30
※株式会社エンジニアリングラボ
社製ディスペンス装置
Dispensing equipment manufactured by
Engineering Labs, Inc.

